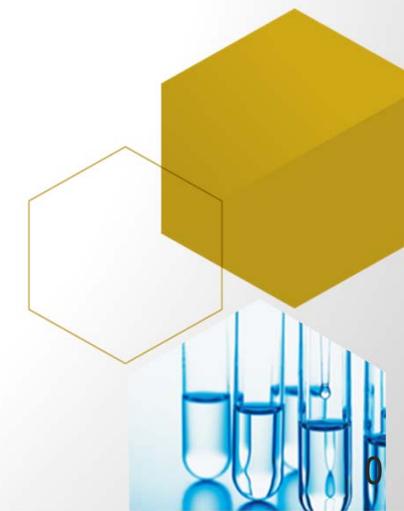
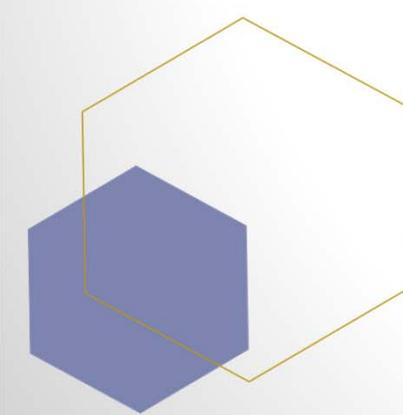


# 2019年3月期 決算説明資料

---



 日本高純度化学株式会社

証券コード:4973

2018年7月24日

## 電子部品業界の状況

- 前事業年度下期から続くスマートフォン市場の飽和状態に伴い、需要鈍化傾向が見受けられていたが、徐々に明るさが戻りつつある。

## 当社決算の概況

- パッケージ基板やスマートフォン向けの無電解めっき薬品の販売については、底堅い電子部品需要に支えられて前年同期と比較して好調に推移した。
- コネクタ用硬質金めっき薬品の販売についても同様に堅調に推移した。
- リードフレーム用パラジウムめっき薬品の販売については、前事業年度から続く貴金属パラジウム価格の高止まりに伴い、引き続き販売価格を押し上げる結果となった。

# 2019年3月期 第1四半期決算概況

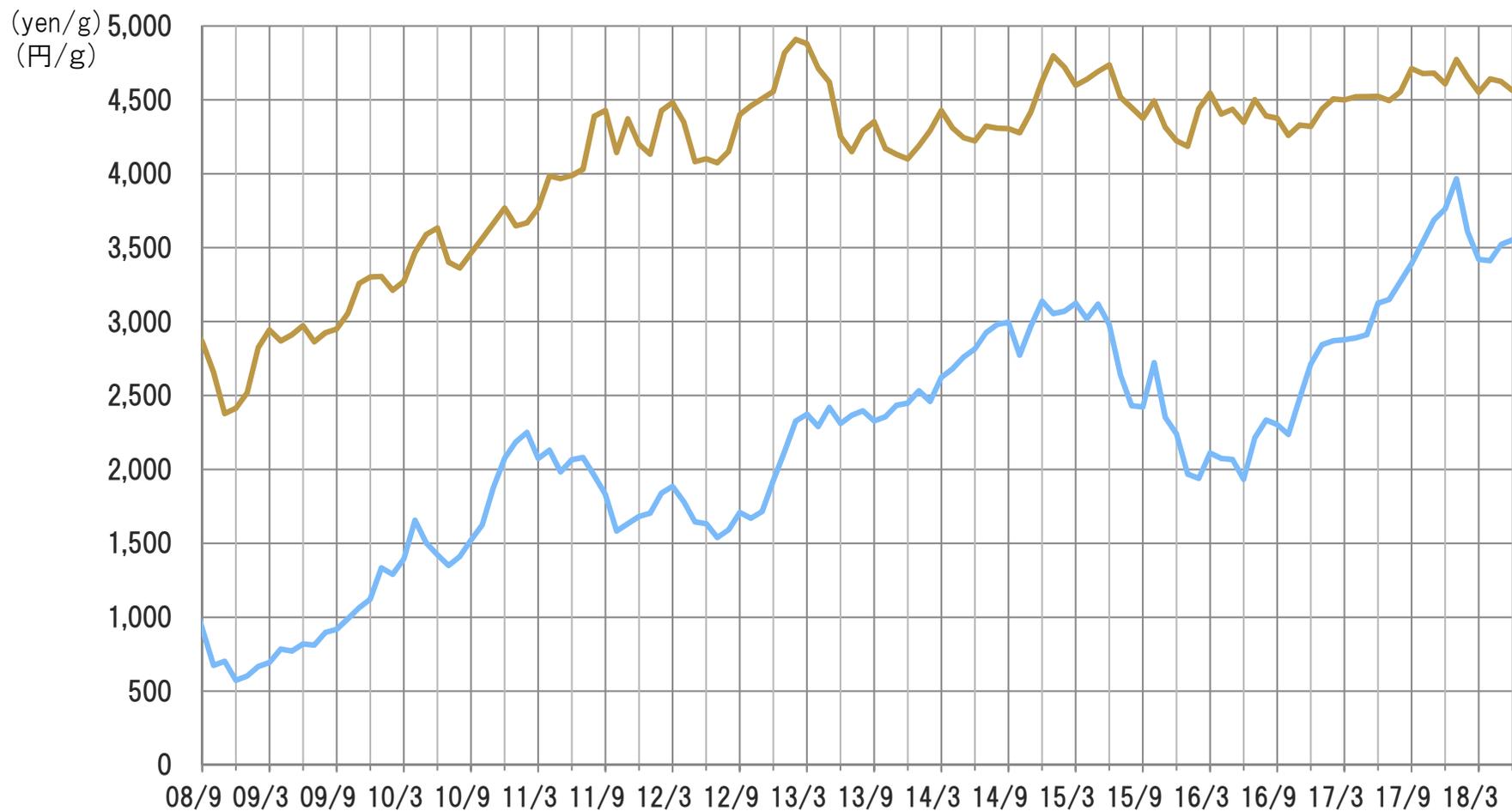
(単位:百万円、%)

	2018/3期 1Q	2019/3期		2019/3期予想	
		1Q	増減率		達成率
売上高	2,360	2,925	23.9	10,200	28.7
営業利益	265	273	3.2	1,130	24.2
経常利益	312	343	9.9	1,230	28.0
純利益	221	251	13.8	860	29.3
1株当たり 当期純利益	38.51円	43.71円	—	149.36円	—

# メタル相場推移

Prices of gold and palladium  
金、パラジウム価格

Gold 金  
Palladium パラジウム

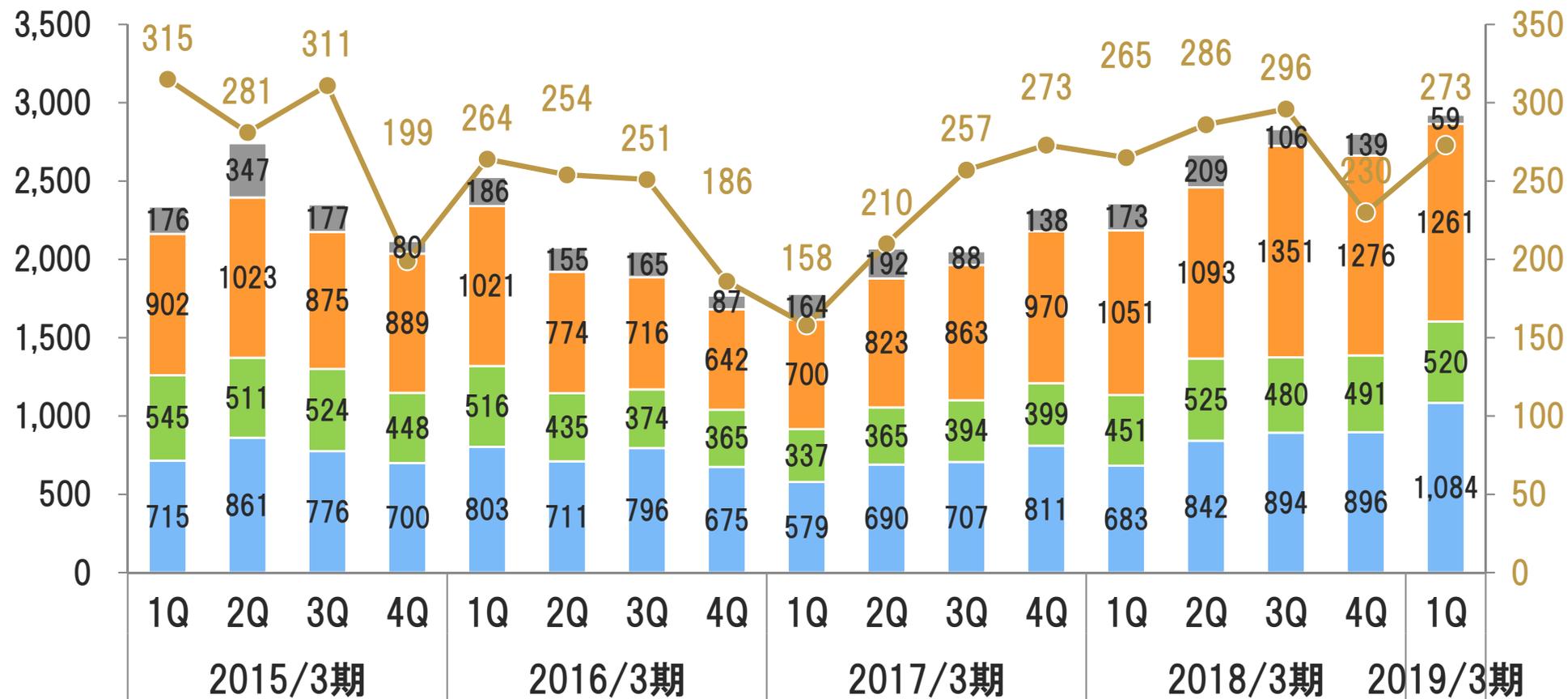


# 売上高・営業利益の推移(四半期ベース)

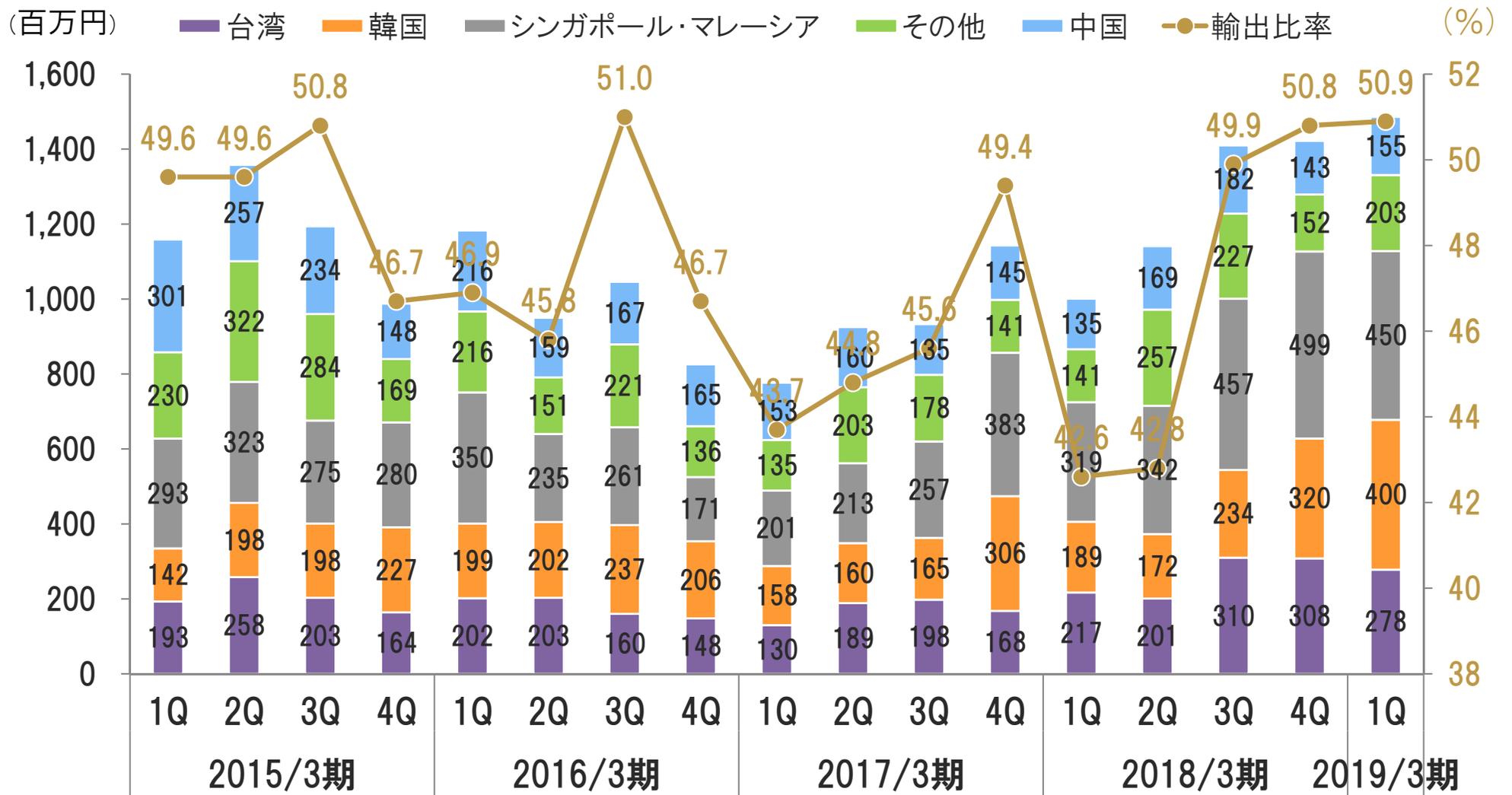
(百万円)

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクター・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他
- 営業利益

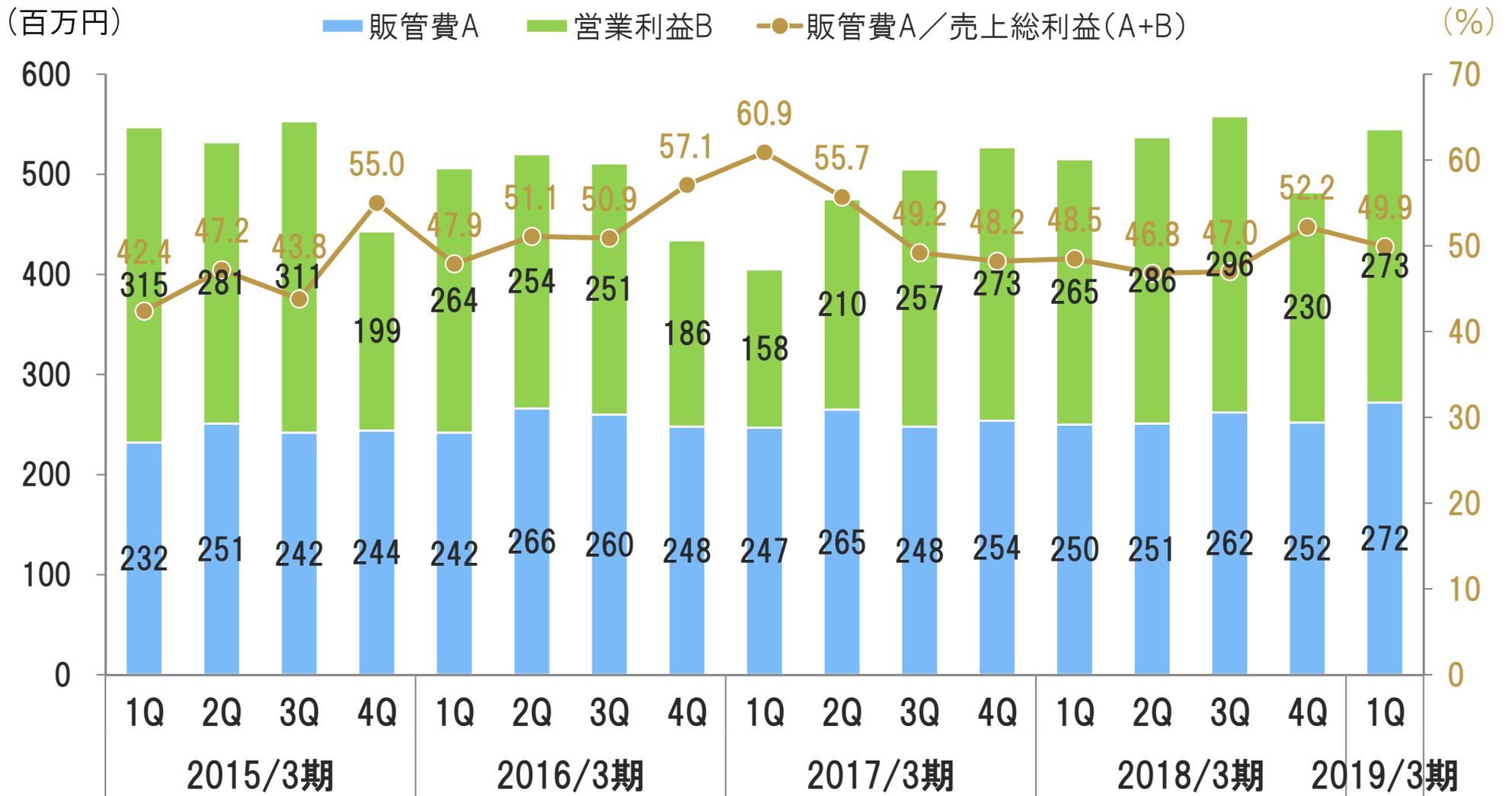
(百万円)



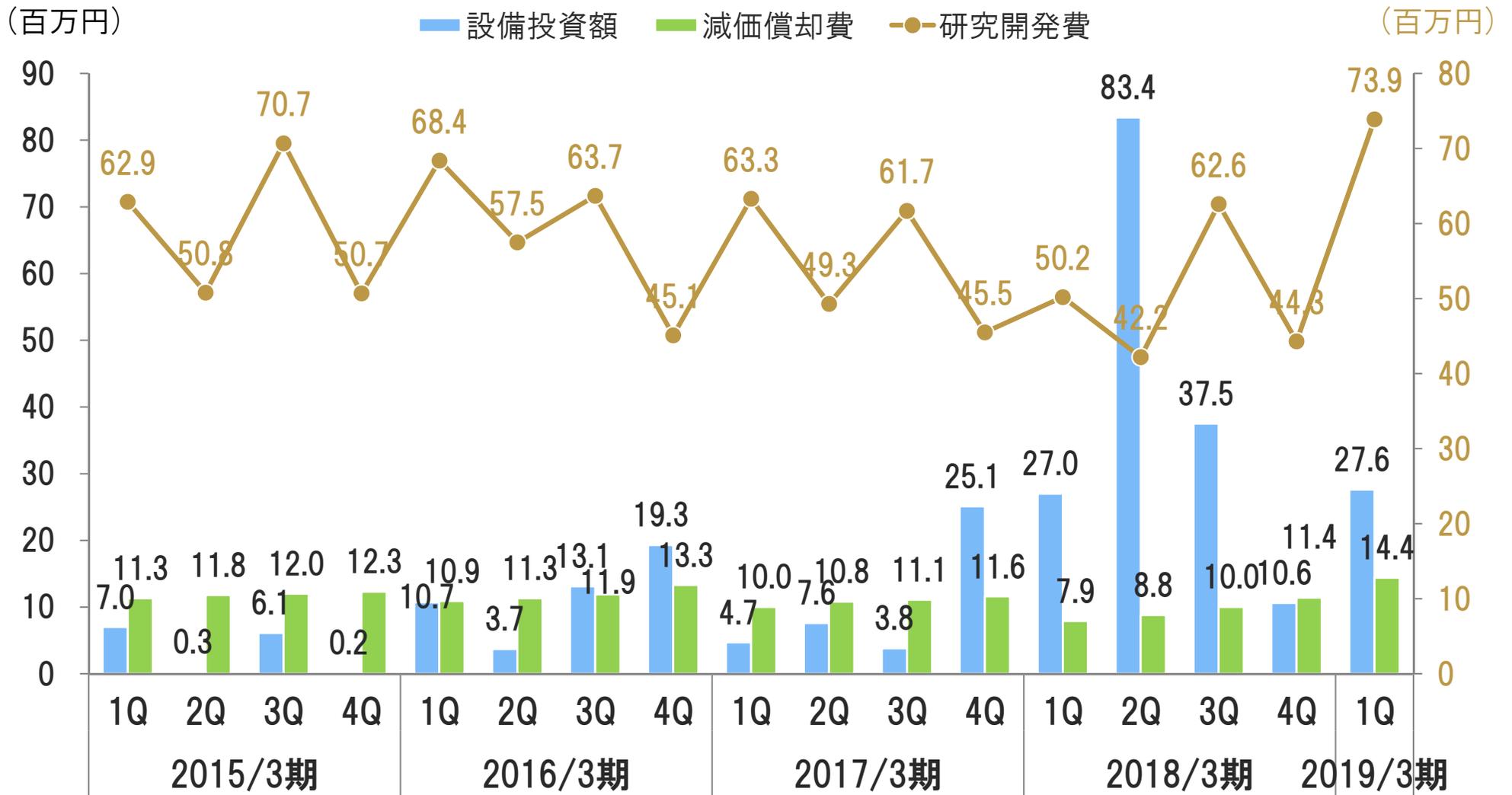
# 輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)



# 販売管理費および営業利益の推移



# 設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



# 株主還元について

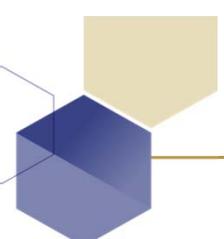
## 一株当たり配当金

(単位:円、%)

	通期	EPS	配当性向
2015/3期	80	131.87	60.7
2016/3期	80	121.31	65.9
2017/3期	80	124.44	64.3
2018/3期	80	144.13	55.5
2019/3期(予想)	80	149.36	53.6

# 製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

	めっき方式	用途	製品ラインアップ		
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき		
	硬質金 (金合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7		
	電解Pd		PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2		
無電解	置換金		低金濃度で使える置換金めっき IM-GOLD FG 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN		
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN		
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 <b>ダイレクト</b> 還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP		
新分野	新分野		後処理剤 合金めっき	還元Snめっき	ビアフィルめっき



# まとめ：開発型企业として新技術の開発を推進

- JPC固有技術であるProtecting Agent(※)の種類を増やし、新しい基板素材との組合せにより“新技術”を提案する。

※特定の金属に選択的に吸着し、電子を供与又は求引する効果によって、めっき反応や皮膜物性をコントロールする一連の有機化合物

- 合金めっき、後処理剤、卑金属めっきなどの“新技術”から次世代の柱となる事業を育成することにより、スマートフォンへの依存度の高い企業体質から脱却する。

# 通期の見通し

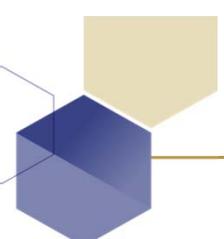
(単位:百万円、%)

	2018/3期			2019/3期		
		構成比	前期比		構成比	前期比
売上高	10,668	100.0	29.6	10,200	100.0	△4.4
営業利益	1,078	10.1	19.8	1,130	11.1	4.8
経常利益	1,179	11.1	17.6	1,230	12.1	4.3
当期純利益	829	7.8	15.7	860	8.4	3.7

## トピックス

- **貴金属パラジウム(Pd)**・・・地金価格の高騰が落ち着き、Pd含有製品の売上高減少と予想
- **硬質金(金合金)**・・・マイクロコネクタ用硬質金めっきの改良製品の投入により、利益向上を見込む
- **ENIG(置換金)**・・・電子部品の世界の工場として伸長する東南アジア市場にて需要拡大
- **DIG(銅上ダイレクト金)**・・・ENIGに代わる高周波特性・高解像度対応プロセスとして拡販中
- **EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)**・・・巨大なIoT市場に展開できるよう、技術・営業両面でフォロー中

いずれも業界動向や顧客ニーズに迅速に対応できるよう積極的に拡販活動をおこなっております。



# 注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2018年6月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

---

## お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>